



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080818002A

2009 年 6 月 8 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイト変更のご案内
(認定済 28 製品への追加認定 7 製品の連絡)

(第二版 PCN20080818002 2008 年 12 月 12 日発行、初版 PCN20080818002 2008 年 8 月 27 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Test	☒ Site ☐ Process
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について認定済 28製品への追加認定 7製品の連絡になります。 TI-Tucson 製造一部製品 組立/検査サイト変更 現行：TI-Tucson (USA) 変更後：MMT 社(旧 ALP 社:Thailand) 注)ALP (AlphaTec) 社は MMT (Millennium Microtech) 社になっています。	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	1 月下旬の出荷より実施しています。 追加認定品は 7 月中旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済28製品への追加認定7製品の連絡になります。
 弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイトについて、
 TI-Tucson製造終了に伴い、製品供給能力維持確保の為に、TI-Tucsonサイトに替わり MMT社
 (Millennium Microtech社:旧ALP社(タイ))での製造に移行し認定いたしました。変更品の出荷につ
 きましては本通知日の30日以降を予定いたしております。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸
 法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

組立/検査サイト

現行

TI-Tucson

変更後

MMT社(旧ALP社)

理由：製品供給能力維持確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
□：認定終了品 ■：追加認定品				
ADS7800AH	ISO102B	ISO121G	OPA2541BM	OPA541BM
ADS7800BH	ISO106	LOG100JP-2	OPA2541SM	OPA541SM
DAC811AH	ISO106B	MPY100AG	OPA2541SMQ	OPA637SM
DAC811BH	ISO120BG	MPY100BG	OPA404AG	XTR101AG
INA101AG	ISO120G	MPY100CG	OPA404BG	XTR101BG
INA110SG	ISO120SG	MPY100SG	OPA404SG	XTR110AG
ISO102	ISO121BG	OPA2541AM	OPA541AM	XTR110BG

製品表示

今回の変更の伴い出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び原産国(ラベル箇所:23L)が各々
 下記の様になります。

	現行	変更後
組立サイト	TI-Tucson	MMT 社
原産地(22L)	BRB	ALP
原産国(23L)	USA	THA



図1 出荷ラベルの表示箇所の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

DEVICE-ID	A	B	C
Qual Device:	ADS7800BH	INA110SG	XTR110BG
Die Size (mils)	C / 136 X 184	T / 89 X 139	78 x 109
Wafer fab Site	TUA	TUA	SFAB/HFAB
Technology	Bipolar	Bipolar	Bipolar
Fab Process	490N	-	630G
Resistor technology	-	-	SiCr
Assembly Site	MMT	MMT	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JDN / 24	CDIP/ JD/ 16	CDIP/ JD/ 16
Lead Finish	Gold	Gold	Gold

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		A	B	C
Steady-state Life Test	125C, 1000 hrs	94/0	119/0	116/0
Temp Cycle	-65C/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22/0	22/0	22/0
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32/0	32/0	32/0
Bond Strength	76 bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved		
D4 Mechanical Shock	Condition B	32/0	32/0	32/0
D4 Vibration	Condition A	32/0	32/0	32/0
D4 Constant Acceleration	Condition E	32/0	32/0	32/0
Fine and Gross Seal Leak	D4 Sequence	32/0	32/0	32/0
Visual Inspection	Visual/Methods 1010/1011	32/0	32/0	32/0

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	ISO120G	Assembly Site	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JVA / 16	Lead Finish	Gold

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails
Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs	126/0
Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cyc	77/0
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22/0
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0
Die Shear	-	10/0
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved
D4 Mechanical Shock	Condition B	32/0
D4 Vibration	Condition A	32/0
D4 Constant Acceleration	Condition E	32/0
Seal Fine and Gross leak	-	32/0
Visual Inspection	D4 Sequence	32/0

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	XTR101BG	Assembly Site	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JD / 14	Lead Finish	Gold

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved
FTY and Bin Summary	-	Approved

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2541BM	Die Size (mm):	5.44 x 5.26	
Die Protective Coating:	5kASiO2/8kASiON	-	-	
Assembly Site:	MMT (ALP)	Package /Code/ Pin:	TO3/LMF/8	
Mount Compound:	Abletherm 2600AT	Lead Finish:	SnPb	
Bond Wire:	1.25, 4, 12 Mil Dia. Al	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Bond Strength	20 bonds per wire size, min. 3 units	60/0	60/0	60/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Pass	Pass	Pass
Solderability	8 Hrs/ Stm Age	22/0	22/0	22/0
Mechanical Shock	0.5ms/ Y1 6 pulses/1500g Cond. B	32/0	32/0	32/0
Vibration	20 -2000 Hz /20g/Planes xyz Cond. A	32/0	32/0	32/0
Constant Acceleration	30kg Y1 only Cond. E	32/0	32/0	32/0
Seal Leak Fine & Gross	Seal Leak Fine & Gross	32/0	32/0	32/0
Visual Inspection	Visual/Methods 1010/1011	32/0	32/0	32/0
Electrical Test	Electrical test/Post Stress test	32/3*	32/0	32/0
Resistance to Solvents	-	22/0	22/0	22/0
X-ray	Top Side	5/0	5/0	5/0
Temp Cycle	-65/150C,500 cyc	77/0	77/1*	77/1*
Steady-state Life Test	125C, 168, 500, 1000 Hrs	77/1*	77/1*	77/3*
Note: * corrective action - A 160 hour burn-in and centrifuge screen will be done on 100% of product before shipping to screen out marginal units.				